# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(川)特許番号

## 第2504277号

(45) 発行日 平成8年(1998) 6月5日

(24)登錄日 平成8年(1998)4月2日

(51) Int.CL <sup>6</sup>	識別配号	庁内整理番号	ΡI		技術	<b>沒</b> 來當所
H05K 3/46		6921 -4E	H05K	3/4	46 H	
B 2 8 B 11/00			B 2 8 B	11/0	02	
11/02				11/1	14	
11/14			HOIG	4/1	12 364	
H01G 4/12	364	7924-5E		4/3	30 311Z	
					請求項の数2(全 7 頁) 最前	質に続く
(21)出顧番号	<b>特顯平2-103530</b>		(73)特許	<b>指者</b>	999999999	
					株式会社村田製作所	
(22)出驗日	平成2年(1990)4月19日		ļ		京都府長岡京市天神2丁目26報	10号
			(72) 発明	音	小竜 俊彦	
(65)公関番号	特買平4-2196				京都府長岡京市天神2丁目26種	10号 株
(43)公隣日	平成4年(1992)1	月7日	` <b> </b>		式会社村田製作所內	
			(72) 発明	ざ	羽室 光郎	
					京都府長閩京市天神2丁目26世	対 株
					式会社村田製作所内	
			(74)代理.	<b>人</b>	弁理士 深見 久郎 (外2名	<b>5</b> )
			****		中川 隆司	
			(56)参考:	猫文	特開 昭58-18952 (JP,	A)

#### (54) 【発明の名称】 積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造方法および装置

#### (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】長尺のキャリアフィルム上にグリーンセラ ミック層がその長手方向にわたって連続的に形成された 1本の長尺の複合体を準備し、

前記1本の長尺の複合体を、その長尺の形態を維持した まま、順次、印刷ステーション、乾燥ステーション、お よび打抜きステーションに、連続的に導く、

各ステップを備え、

前記印刷ステーションにおいては、前記グリーンセラミ され.

前記乾燥ステーションにおいては、前記印刷された準電 膜が乾燥され、

前記打抜きステーションにおいては、前記導電膜が印刷

合わせされた状態で打抜かれ、かつ前記キャリアフィル ムから剥離され、それによって積層型セラミック電子部 品用セラミックグリーンシートが取出される、

**緬層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシート** の製造方法。

【톎求項2】長尺のキャリアフィルム上にグリーンセラ ミック層がその長手方向にわたって連続的に形成された 1本の長尺の複合体を供給する供給源と、

前記供給源から引出された前記1本の長尺の複合体に対 ック層の表面上に、導電ペーストをもって導電膜が印刷 10 し、前記グリーンセラミック層の表面上に導電ペースト をもって導電膜の印刷を行なう印刷ステーションと、

前記印刷ステーションを通過した前記長尺の複合体に対 し、前記導電膜の乾燥を行なう乾燥ステーションと、

前記乾燥ステーションを通過した前記長尺の複合体に対

わせされた位置で打抜き、かつ前記キャリアフィルムから別能し、それによって積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートを取出すことを行なう。打抜きステーションと、を備える、積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造鉄廠。

3

#### 【発明の詳細な説明】

#### [産業上の利用分野]

との発明は、積層型セラミック電子部品を製造する際 に用いられるセラミックグリーンシートの製造方法およ び装置に関するものである。

#### [従来の技術]

セラミックグリーンシートを論層して得られる積層型 セラミック電子部品には、たとえば、積層セラミックコ ンデンサ、論層インダクタ、多層回路基板、等がある。 その最も代表的な例となる積層セラミックコンデンサ は、一般に、次のように製造されていた。すなわち、

- (1) グリーンセラミックからなるマザーシートを矩形に打抜き、積層に供されるセラミックグリーンシートを得る。
- (2) 矩形のセラミックグリーンシートに、内部電極 20 を印刷する。
- (3) 印刷された内部電極を乾燥する。
- (4) このようにして得られた、第1のパターンを有する内部電極が形成されたセラミックグリーンシートと、第1のパターンとは異なる第2のパターンを有する内部電極が形成されたセラミックグリーンシートとを交互に積重ねる。
- (5) これら積重ねられたセラミックグリーンシート を、その外形を基準として描える。
- (6) 次いで、上述のようにして得られたセラミック グリーンシートの領層体を、金型内に入れて加圧する。
- (7) 次いで、個々の積暑セラミックコンデンサとなるべきチップを得るように、積層体を切断した後、焼成および外部電極形成の各ステップを実施し、所望の積層セラミックコンデンサを得る。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した積層セラミックコンデンサの製造方法において、まず、(1)のステップにおいて矩形のセラミックグリーンシートを得た後、(2)のステップにおいて内部電極の印刷を行なうととになる。した 40がって、内部電極の印刷において位置ずれが生じた場合。(5)のステップにおいてセラミックグリーンシートの外形を基準として領重ねが行なわれるため、そのような内部電極の位置ずれば、最終製品にまで待ち込まれてしまう。したがって、積層セラミックコンデンサにおいては、取得される静電容量にばらつきが生じやすい。また、上述の(5)のステップでは、セラミックグリーンシートに振動等を加えて、それぞれの外形が揃うように積重ね状態での位置合わせが行なわれるが、セラミ

重ねの精度を高めることができない。このことも、特に 積暑セラミックコンデンサにおいては、取得される静電 容量のばらつきを招く原因となる。

また、上述した(2)~(5)の各ステップにおいては、セラミックグリーンシートを、直接、取扱うことが必要であるが、このような取扱いは、セラミックグリーンシートが薄くなるにつれて、より困難なものとなる。それゆえに、この発明の目的は、上述したような問題を解消し得る。 積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造方法および装置を提供しようとすることである。

#### [課題を解決するための手段]

この発明は、上述した技術的課題を解決するため、長 尺のキャリアフィルム上にグリーンセラミック層がその 長手方向にわたって連続的に形成された長尺の複合体を 30 進儲するステップと、1本の長尺の複合体を、1本のそ の長尺の形態を維持したまま、順次、印刷ステーショ ン、乾燥ステーション、および打抜きステーションに、 連続的に導く各ステップを備える、積層型セラミック電 子部品用セラミックグリーンシートの製造方法を提供す る。上述した印刷ステーションにおいては、グリーンセ ラミック層の表面上に、導電ペーストをもって導電膜が 印刷される。また、乾燥ステーションにおいては、前記 印刷された導電膜が乾燥される。さらに、打抜きステー ションにおいては、導電膜が印刷されたグリーンセラミ ック層が、導電膜と位置合わせされた位置で打抜かれ、 かつキャリアフィルムから剥離され、それによって積層 型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートが取 出される。

また、この発明では、上述したような方法を実施する ための装置が提供される。この装置は、長尺のキャリアフィルム上にグリーンセラミック層がその長手方向にわ たって連続的に形成された1本の長尺の複合体を供給す る供給額と、前記供給額から引き出された前記1本の長 尺の複合体に対し、前記グリーンセラミック層の表面上 (3)

ーションと、前記印刷ステーションを通過した前記長尺の複合体に対し、前記導電機の乾燥を行なう乾燥ステーションと、前記乾燥ステーションを通過した前記長尺の複合体に対し、前記グリーンセラミック層を、前記導電膜と位置合わせされた位置で打抜き、かつ前記キャリアフィルムから剥離し、それによって積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートを取出すことを行なう。打抜きステーションとを備えることを特徴としている。

#### [作用]

この発明においては、積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートを得るため、1本の長尺のキャリアフィルム上に形成されたグリーンセラミック層は、そこに内部電極のような準電膜を印刷するステップから、セラミックグリーンシートを取出すためにそれを打抜くステップまでの間、長尺のキャリアフィルム上に保持された状態で、かつその長尺の形態を維持したまま、連続的に取扱われる。

#### [発明の効果]

したがって、この発明によれば、所定の寸法および形 20 状に打抜かれたセラミックグリーンシートを得るために 種々の処理が縮されるグリーンセラミック層が、キャリアフィルムによって裏打ちされた状態で鍛送等の取扱いを受けるため、グリーンセラミック層の小さい機械的強度がキャリアフィルムによって有利に補填される。したがって、たとえば30μm以下といった薄いグリーンセラミック層であっても、取扱いに際して変形や破損が生じにくく、高い信頼性をもってセラミックグリーンシートを製造することができる。

また、長尺の形態を維持したまま、グリーンセラミック層に対して、連続的に、所望の処理が施されるので、グリーンセラミック層のクリーン度を保ちやすい。それゆえに、高品質のセラミックグリーンシートを得ることが容易である。

また、長尺の複合体の状態で、導電機が印刷され、その後の工程において、打抜きが実施され、所望の幾何学的形態を有するセラミックグリーンシートが取出されるので、導電膜の印刷のずれは、後で実施される打抜きステップにおいて補償するととができる。そして、打抜かれたセラミックグリーンシートにおいては、導電膜の不 40 所望なずれを生じていないので、打抜き時における位置台わせを維持したままセラミックグリーンシートを補層すれば、得られた補層型セラミック電子部品において、内部電極等の導電膜の位置ずれが生じない。

また、この発明によれば、グリーンセラミック層に導 電膜を印刷した後、このグリーンセラミック層から打抜 かれてセラミックグリーンシートが取出される。したが って、グリーンセラミック層に対する導電膜の印刷の位 置およびグリーンセラミック層からセラミックグリーン 整可能とすることにより、たとえば慎層セラミックコン デンサにおける内部電極の対向面積が異なる、すなわち 取得静電容量の異なる複数の種類の積層型セラミック電 子部品を容易に得ることができる。

#### [実能例]

第1図は、この発明の一実施例による福層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造装置を示す図解図である。

まず、この製造装置は、長尺のキャリアフィルム上に グリーンセラミック層がその長手方向にわたって連続的 に形成された長尺の復合体1を供給する供給源となる供 給リール2を備える。供給リール2から引き出された復 台体1は、グリーンセラミック層を上方に向けた状態 で、以後の各ステーションに導かれる。供給リール2か ら引き出される複合体1は、そのテンションがコントロールされ、かつその幅方向での位置がコントロールされ ることが望ましい。

複合体1は、次いで、グリーンセラミック層不良検知 部3に導かれる。ここでは、グリーンセラミック層の不 良が、目視または光学式検知器4により検出され、その 情報がコントローラ5に送られる。

次いで、復合体1は、印刷ステーション6に導かれ る。印刷ステーション6には、複合体1を鍛送するため のコンベア7または吸引機構を有する往復動可能なスラ イダや吸引ロール等が設けられる。また、この印刷ステ ーション6においては、複合体1に含まれるグリーンセ ラミック層の表面上に、導電ペーストをもって導電膜が 定ビッチで印刷される。この印刷には、たとえばスクリ ーン印刷が用いられる。したがって、コンベア?の上方 30 には、スクリーン8、導電ペーストをスクリーン8上に 引き延ばすスクレーパタおよびスクリーン8を通して導 電ペーストをグリーンセラミック層の表面上に付与する スキージ10が配置される。なお、グリーンセラミック層 不良検知部3において、グリーンセラミック層に不良が 存在することが検出されたときには、そのような不良部 分に対しては、 導電膜の印刷が実施されないようにする ことが好ましい。印刷ステーション6においては、導電 膜の印刷と同時に、位置合わせ用マークが印刷されても £41.

次いで、複合体1は、印刷不良検知部11に導かれる。 ことにおいて、上述した印刷の不良が、目視または光学 式検知器12により検出され、その情報がコントローラ5 に入力される。コントローラ5は、印刷不良部分をセラ ミックグリーンシートの積層に除して使用しないよう に、後述する打抜きステーション13における動作を制御 する。この場合、使用しない不良部分による印刷の不足 分は、自動的に追加印刷されて補正される。

次いで、彼合体 l は、乾燥ステーション14に導かれる。乾燥ステーション14には、上方より温風を複合体 l

伝熱により加熱する熱盤16を備える乾燥炉17が配置され る。なお、乾燥ステーション14において、赤外線を使用 する場合もある。乾燥ステーション14においては、印刷 ステーション6において印刷された導電膜の乾燥が行な われる。

7

次いで、彼合体)は、ダンサーロール18に巻掛けされ る。これによって、前述した印刷ステーション6と後述 する打抜きステーション13との間にある復合体1のテン ションがコントロールされるとともに、印刷ステーショ における複合体 1 の送り量との差が吸収される。 との送 り量の差は、打抜きステーション13における打抜きが、 印刷された導電膜や位置合わせ用マークを基準として行 なわれるため、累積されることはない。

次いで、複合体1は、打抜きステーション13に導かれ る。打抜きステーション13には、複合体1を鍛送するた めのコンベア19と、コンベア19の上方に複合体1を介し て配置されるビックアップ装置20とを備える。ビックア ップ装置20は、グリーンセラミック層に切断線を形成す るための切断刃21を備える。打抜きステーション13の詳 20 細が、第2図または第3図に示されている。

第2図を参照して、その左側に、キャリアフィルム22 上にグリーンセラミック層23が形成された彼合体 1 が示 されている。複合体1は、第1図に示したコンベア19に 値えるコンベアベルト24上に置かれた状態となってい る。なお、図示しないが、コンベアベルト24には、多数 の細孔が設けられていて、これら細孔を介して負圧が与 えられることによって、グリーンセラミック層23は、キ ャリアフィルム22を介してコンベアベルト24に対して位 置決めされることが好ましい。

コンベアベルト24の上方に配置された前述のビックア ップ装置20は、矢印25で示すように、コンベアベルト24 に対して近接・解隔可能に設けられる。ピックアップ装 置20は、これから積層されようとするセラミックグリー ンシート26の一方主面に接触する接触面27を与えるへっ ド28を備える。前述した切断刃21は、接触面27を取聞み かつ接触面27から突出するようにヘッド28の周囲に配置 される。ヘッド28は、接触面27に関口する複数個の空気 穴29を形成している。また、切断刃21は、ヘッド28の周 面上において所定の範囲だけ上下方向にスライド可能な スライダ30に固定的に取付けられている。スライダ30に 対しては、圧縮ばね31によって、意に下方へ向く力が与 えられている。

とのようなピックアップ装置20が、コンベアベルト24 に近接されたとき、切断刃21は、グリーンセラミック圏 23の所定の領域に閉ループをなす切断線32を形成する。 このとき、切断刃21は、圧縮はね31の弾性に抗したスラ イダ30のスライドに伴なって、接触面27からの突出度合 を、グリーンセラミック層23に切断線32を形成するに足

方へ相対的に移動する。すなわち、切断線32は、グリー ンセラミック層23にのみ形成され、キャリアフィルム22 には、少なくともそこを質道するような切断線が形成さ れないようにされる。

次に、ピックアップ装置20が、コンベアベルト24から 離隔される。これによって、切断線32で囲まれた領域が 与えるセラミックグリーンシート26が、第2図の左側に 示すように、グリーンセラミック層23から取出される。 このとき、ヘッド28に設けられた空気穴29には、負圧が ン6における複合体!の送り置と打抜きステーション13 10 与えられており、これから積層されようとするセラミッ クグリーンシート26は、接触面27に吸着される。

> なお、上述したような切断刃21による切断線32の形成 に際しては、グリーンセラミック層23上に印刷された導 電膜に対して切断刃21を適用する場所を正確に位置合わ せしなければならない。そのため、導電膜と同時に印刷 される前述した位置合わせ用マークが用いられ、このマ ークを、たとえば光学式センサで検知して、それによっ て得られる情報からピックアップ装置20の位置が調整さ れる。また、複合体1の扱送は、コンベアベルト24に限 ちず、吸引スライダや吸引ロール等を用いて行なっても よい。このような場合は、定盤等を用いてセラミックグ リーンシート26を切り出せばよい。

次に、矢印33で示すように、ピックアップ装置20が、 満重ねテーブル34の上方へ移動される。

積重ねテーブル34は、ヒータ35を内蔵しており、加圧 装置を兼ねた上下動駆動装置36により、矢印37で示すよ うに、上下方向に移動可能である。また、積重ねテーブ ル34上には、積層台38が配置される。

第2図の右側に示すように、ピックアップ装置20が積 30 重ねテーブル34の上方へ移動されてきたとき、積重ねテ ーブル34は、上方へ移動される。これによって、積層台 38上に既に置かれているセラミックグリーンシート26と ピックアップ装置20によって鍛送されてきたセラミック グリーンシート26とが、ヒータ35によって加熱されなが ら、 互いに圧着される。

次いで、補重ねテーブル34が下降され、ピックアップ 装置20側に保持されていたセラミックグリーンシート26 が、積重ねテーブル34側に保持される状態とされる。こ のとき、セラミックグリーンシート26とピックアップ鉄 置26の接触面27との分離を容易にするため、空気穴29に 正圧を与えてもよい。

以後、同様のステップが所望の回数だけ疑返され、積 磨台38上に、セラミックグリーンシート26が所望の綺層 数だけ綺層される。

なお、上述したセラミックグリーンシート26の積重ね ステップにおいて、ピックアップ装置20によって搬送さ れてきたセラミックグリーンシート26が綺層台38上にあ るセラミックグリーンシート26上に置かれたとき、空気 穴29に正圧が与えられると同時に、セラミックグリーン

ート26相互の積層状態を固定するようにしてもよい。こ のとき、論層状態の固定をより強固にするため、積層さ れたセラミックグリーンシート26の周毎部において、加 熱とてを適用して、これによって綺層方向に関して圧力 を加えるようにしてもよい。

9

第3図には、第2図に示したセラミックグリーンシー ト26の打抜きおよび補重ねを行なう装置に代えて用いら れる装置が示されている。第3図に示した装置は、第2 図の左側に示した装置に類似している。したがって、対 応する要素には同様の容照番号を付し、重複する説明は 10 省略する。

第3図に示したピックアップ装置20は、それ自身によ って、セラミックグリーンシート26の打抜きばかりでな く」セラミックグリーンシート26の積層を行なうように 樺成されている。このような理由から、切断刃21の、接 鮭面27からの突出度合は、第2図に示した装置における 切断刃21の、接触面27からの突出度合より大きく選ばれ ている。

第3図に示した装置の動作について説明する。まず、 れによって、切断刃21によってグリーンセラミック層23 の所定の領域に閉ループをなす切断線32が形成される。 このとき、切断刃21は、圧縮はね31の弾性に抗したスラ イダ30のスライド動作を伴ないながら、グリーンセラミ ック層23に切断線32を形成するに足りる突出状態になる まで、ヘッド28に対して相対的に上方へ変位する。

次に、ピックアップ装置20は、コンベアベルト24から 離隔される。これによって、切断線32によって囲まれた 領域が与えるセラミックグリーンシート26が、ビックア ップ装置20の退避に伴なってグリーンセラミック層23か。 ら切り出される。このとき、ヘッド28に設けられた空気 穴29には、負圧が与えられており、積暑されるべき最初 のセラミックグリーンシート26(a)は、接触面27上に 吸着されるとともに、キャリアフィルム22から剥削され る.

その後、同様のステップが繰返され、切断刃21に聞ま れた空間内において、所望の論層数のセラミックグリー ンシート26のすべてが領層される。

なお、2番目以降のセラミックグリーンシート26をグ リーンセラミック層23から打抜くとき、より正確には、 2番目以降のセラミックグリーンシート26を打抜くため にグリーンセラミック層23に切断線32を形成するため、 ピックアップ装置20をコンベアベルト24に近接させたと き ビックアップ装置20とコンベアベルト24との間に、 たとえば、20kg/cm 程度の圧力が加わるようにされる。

また、コンベアベルト24は、ヒータ (図示せず) により 加熱され、たとえば、約90°Cの温度に保たれる。このよ うにして、積層されるセラミックグリーンシート26は、 相互に熱圧者される。

10

上途したコンベアベルト24に与えられる加熱は、セラ ミックグリーンシート26中に含まれるバインダを溶融 し、钻性を増すように作用する。このようなバインダの 溶融は、綺麗されるセラミックグリーンシート26相互間 の接合度台を高めるとともに、セラミックグリーンシー ト26がキャリアフィルム26から剥離されることをより容 易にする。

このように、ビックアップ装置20の接触面27上でセラ ミックグリーンシート26が所望の領層数だけ領層された 後、セラミックグリーンシート26の積層体は、ビックア ップ装置20から取出される。このとき、好ましくは、空 気穴29に正圧が与えられることによって、このような取 出しがより容易にされる。

なお、前述したように、印刷ステーション6で実施さ れた導電膜の印刷の不良が、印刷不良検知部立で検出さ ピックアップ装置20がコンベアベルト24に近接され、そ 20 れるなど、不良部分が検出された場合には、コントロー ラ5によって、打抜きステーション13における打抜き動 作が実施されないようにされる。

> 再び第1図を参照して、打抜きステーション13におい て、前述したように、グリーンセラミック層23の所定の 部分がセラミックグリーンシート26として取出された後 の複合体上は、そのテンションがコントロールされなが ら、巻取リール39に巻取られる。

> 前途した打抜きステーション13において、切断刃21の グリーンセラミック圏23上の導電膜との位置合わせを、 数値副御等により選択して、適当にずらすことにより、 たとえば綺麗セラミックコンデンザにおいては、その取 得辞電容量を任意に変更することができる。

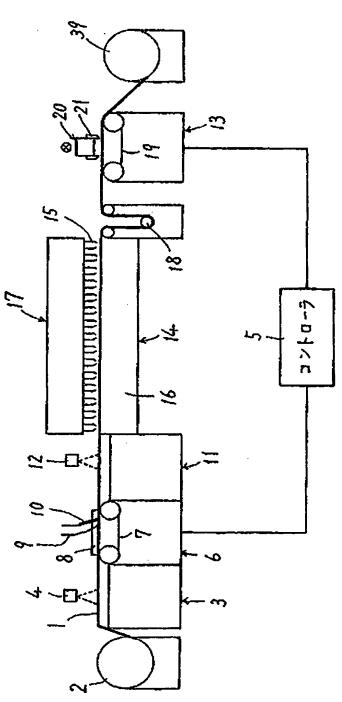
#### 【図面の簡単な説明】

第1回は、この発明の一実施例による積層型セラミック 電子部品用セラミックグリーンシートの製造装置を示す 図解図である。第2図は、第1図に示した打抜きステー ション13において設けられる装置を拡大して示す断面図 である。第3回は、第2回に示した装置に代えて用いら れる装置を拡大して示す断面図である。

49 図において、1は彼合体、2は供給リール、6は印刷ス テーション、13は打抜きステーション、14は乾燥ステー ション、21は切断刃、22はキャリアフィルム、23はグリ ーンセラミック層、26はセラミックグリーンシートであ



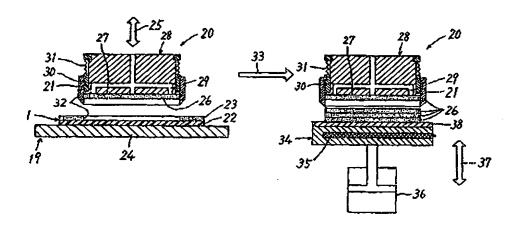
(6)



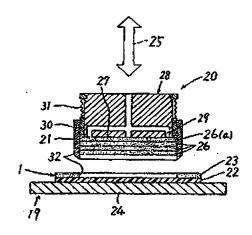
(7)

特許2504277

【第2図】



【第3図】



フロントページの続き

 (51)Int.Cl.\*
 識別記号
 庁内整理番号
 FI
 技術表示箇所

 H 0 l G
 4/30
 3 l l
 7924-5E
 H 0 l G
 13/00

 13/60
 B 2 8 B
 11/00
 Z

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DETAILED DESCRIPTION**

### [Detailed Description of the Invention]

[Industrial Application]

This invention relates to the manufacture approach of a ceramic green sheet and equipment which are used in case laminating mold ceramic electronic parts are manufactured.

[Description of the Prior Art]

There are a stacked type ceramic condenser, a laminating inductor, a multilayered circuit board, etc. in the laminating mold ceramic electronic parts obtained by carrying out the laminating of the ceramic green sheet. Generally the stacked type ceramic condenser used as the most typical example was manufactured as follows. Namely, (1) The ceramic green sheet with which a rectangle is presented in blanking and a laminating in the mother sheet which consists of a Green ceramic is obtained.

- (2) Print an internal electrode to a rectangular ceramic green sheet.
- (3) Dry the printed internal electrode.
- (4) Accumulate by turns the ceramic green sheet which was obtained by doing in this way and with which the internal electrode which has the 1st pattern was formed, and the ceramic green sheet with which the internal electrode which has the 2nd different pattern from the 1st pattern was formed.
- (5) arrange a these pile \*\*\*\* ceramic green sheet on the basis of the appearance.
- (6) Subsequently, put in the layered product of the ceramic green sheet obtained as mentioned above in metal mold, and pressurize it.
- (7) Subsequently, carry out each step of baking and external electrode formation, and obtain a desired stacked type ceramic condenser, after cutting a layered product so that the chip which should serve as each stacked type ceramic condenser may be obtained.

[Problem(s) to be Solved by the Invention]

However, in the manufacture approach of the stacked type ceramic condenser mentioned above, first, after obtaining a rectangular ceramic green sheet in the step of (1), an internal electrode will be printed in the step of (2). Therefore, since a pile is performed on the basis of the appearance of a ceramic green sheet in the step of (5) when a location gap arises in printing of an internal electrode, such a location gap of an internal electrode will be carried even into a final product. Therefore, in a stacked type ceramic condenser, it is easy to produce dispersion in the electrostatic capacity acquired.

Moreover, at the above-mentioned step of (5), alignment in a condition is performed in accumulation so that an oscillation etc. may be added to a ceramic green sheet and each appearance may gather, but since a ceramic green sheet has the comparatively low mechanical strength, it cannot raise precision of a pile. It becomes the cause which causes dispersion in the electrostatic capacity from which this is also acquired especially in a stacked type ceramic

condenser.

Moreover, the acquisition electrostatic capacity of a stacked type ceramic condenser will be mostly determined by the step of (2) mentioned above. That is, at the step of (2), it is already pierced by the rectangle, and since an internal electrode is printed by the ceramic green sheet with which the appearance was determined by it and a condition is arranged with it in accumulation on the basis of the appearance of such a ceramic green sheet at the step of (5), if the ceramic green sheet with which the internal electrode which has the pattern of the same class was formed is used at all, the

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

## (57) [Claim(s)]

[Claim 1] Prepare the complex of one long picture with which the Green ceramic layer was continuously formed over the longitudinal direction on the long carrier film, and the gestalt of the long picture has been maintained for the complex of said one long picture. Have each step continuously led to a printing station, a desiccation station, and a blanking station one by one, and it sets to said printing station. On the front face of said Green ceramic layer, have conductive paste, the electric conduction film is printed, and it sets to said desiccation station. Said printed electric conduction film is dried and it sets to said blanking station. Said Green ceramic layer by which said electric conduction film was printed is pierced where alignment is carried out to said electric conduction film. And the manufacture approach of the ceramic green sheet for laminating mold ceramic electronic parts that exfoliate from said carrier film and the ceramic green sheet for laminating mold ceramic electronic parts is taken out by it.

[Claim 2] The supply source which supplies the complex of one long picture with which the Green ceramic layer was continuously formed over the longitudinal direction on the long carrier.

[Claim 2] The supply source which supplies the complex of one long picture with which the Green ceramic layer was continuously formed over the longitudinal direction on the long carrier film, The printing station which prints the electric conduction film with conductive paste to the complex of said one long picture pulled out from said supply source on the front face of said Green ceramic layer, The desiccation station which dries said electric conduction film to the complex of said long picture which passed through said printing station, As opposed to the complex of said long picture which passed through said desiccation station said Green ceramic layer The blanking station which exfoliates from blanking and said carrier film in the location by which alignment was carried out to said electric conduction film, and performs taking out the ceramic green sheet for laminating mold ceramic electronic parts by it, The manufacturing installation of \*\*\*\*\*\*\*\* and the ceramic green sheet for laminating mold ceramic electronic parts.

[Translation done.]